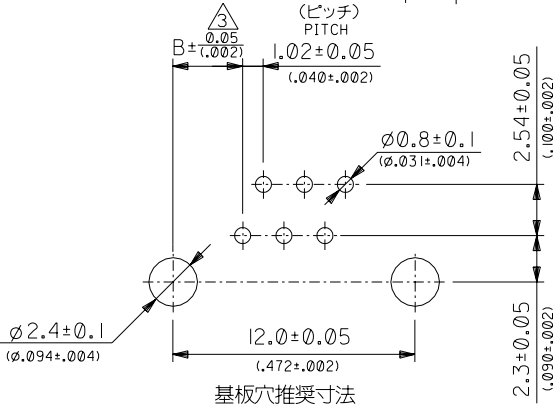
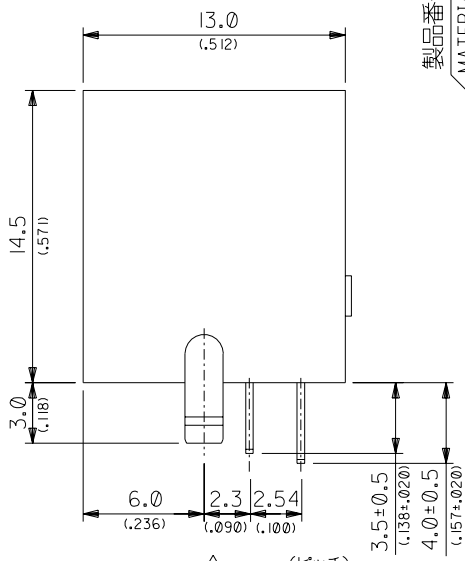
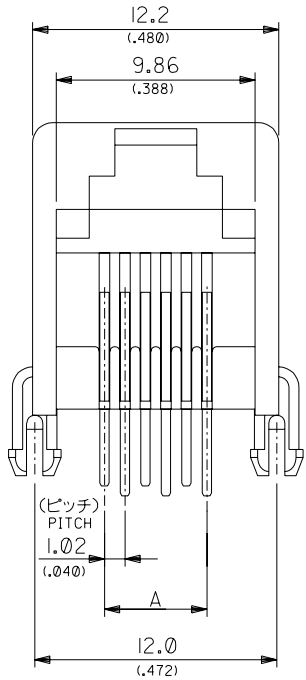
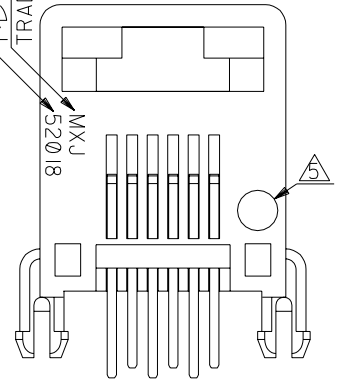


DWG. NO.
SD-52018-003



基板穴推奨寸法
RECOMMENDED P.C.B. LAYOUT
(ジャック取付け側)
(JACK ASS'Y SIDE)

製品番号
MATERIAL NO.
トレードマーク
TRADE MARK



- 注) NOTES
- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリアステル UL94V-0
HSG.: POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM.: PHOSPHOR BRONZE
 - メッキ仕様 PLATING
接点部: 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 錫メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA: TIN 1.0 MICROMETER MINIMUM.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE: NICKEL 1.0 MICROMETER MINIMUM.
 - △ -6.4*6は両端の基板穴を除く。
-6.2*6は両端の2つの基板穴を除く。
DIM B INDICATES FIRST P.C.HOLE
REQUIRED PER PART NUMBER.
FOR PARTIALLY LOADED ASSEMBLIES
P.C.HOLE PATTERN IS REDUCED FROM EACH END.
 - 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
 - △ 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN. YELLOW: 0.1 MICROMETER MINIMUM.
緑色: 0.38µmMIN. GREEN: 0.38 MICROMETER MINIMUM.
オレンジ色: 0.76µmMIN. ORANGE: 0.76 MICROMETER MINIMUM.
無色: 1.27µmMIN. UNMARKED: 1.27 MICROMETER MINIMUM.
 - ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.
 - 本製品は52018-6**5の鉛フリー品である。
THIS PRODUCT IS LEAD FREE OF 52018-6**5.

6	6	5.08 (.200)	3.46 (.136)	1.27 / (50)	52018-6646
				0.76 / (30)	▲ -6636
				0.38 / (15)	-6626
				0.1 / (4)	-6616
6	4	3.05 (.120)	4.48 (.176)	1.27 / (50)	-6446
				0.76 / (30)	-6436
				0.38 / (15)	-6426
				0.1 / (4)	-6416
6	2	1.02 (.040)	5.49 (.216)	1.27 / (50)	-6246
				0.76 / (30)	-6236
				0.38 / (15)	▼ -6226
				0.1 / (4)	52018-6216
ポジション POSITION	極数 CIRCUITS	A	B	金メッキ厚 (µmMIN) GOLD PLATING THK (MIN.)	製品番号 MATERIAL No.

DO NOT SCALE DRAWING

64NO. DRWN: CH'K: APPR:
63NO. DRWN: CH'K: APPR:
62NO. DRWN: CH'K: APPR:
61NO. DRWN: CH'K: APPR:

新緑作成 RELEASED
60NO. J2004-4221
DRWN: M.NAGATA '04/05/14
CH'K: K.TOJO '04/05/14
APPR: M.SASAO '04/05/14

MATERIAL 材料
FINISH 仕上げ
WIRE RANGE 適用電線範囲
INS. RANGE 被覆外径

注参照
SEE NOTES
注及び表参照
SEE NOTES AND CHART

GENERAL TOLERANCES:
(UNLESS SPECIFIED)
一般公差

10 UNDER 未満 ±0.2 (0.08)
10 OVER 30 UNDER 未満 ±0.25 (0.10)
30 OVER 以上 ±0.3 (0.12)

ANGLE 角度 ±3°

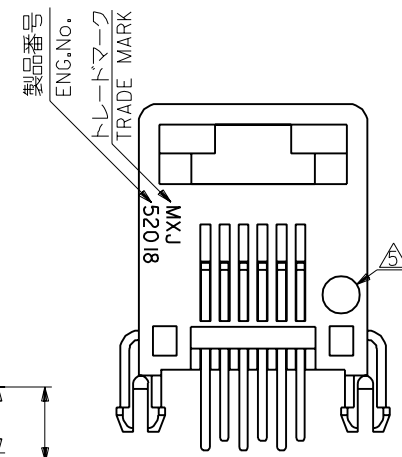
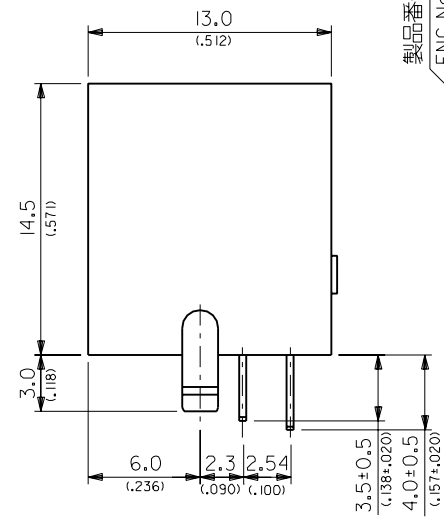
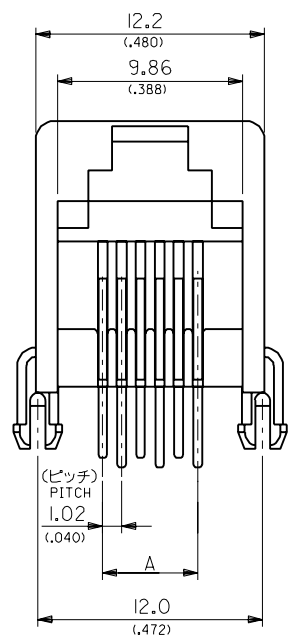
SCALE 4:1
DESIGN UNITS
 mm INCH
DRAWN BY & DATE
M.NAGATA '04/05/14
CHECKED BY & DATE
K.TOJO '04/05/14
APPROVED BY & DATE
M.SASAO '04/05/14
CAD FILENAME
SD-52018-003.S01

MODEL NO. 52018-6**6
DIMENSIONS:
 mm INCH
 mm ONLY
SHT REV
TITLE: MODULAR JACK
HOUSING ASS'Y
-LEAD FREE-
MOLEX MOLEX INCORPORATED
MATERIAL NO. SEE CHART
DRAWING NO. SD-52018-003
SHEET NO. 1 OF 1
SIZE B
THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX
INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION.

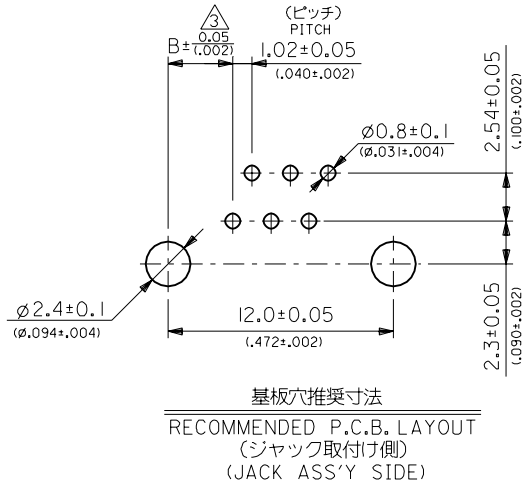
ENC. NO.
SD-52018-6**5

EDP NO. —#—

※MM DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING



- 注) NOTES
- 材質 MATERIAL
ハウジング: ガラス入りポリエステル UL94V-0
HSG. : POLYESTER G.F.15% UL94V-0
ターミナル: リン青銅
TERM. : PHOSPHOR BRONZE
 - メッキ仕様 PLATING
接点部 : 金メッキ、表参照
CONTACT AREA: GOLD PER TABLE
半田付け部: 半田メッキ 1.0µmMIN.
SOLDER AREA : TIN-LEAD 1.0µmMIN.
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.0µmMIN.
UNDERPLATE : NICKEL 1.0µmMIN.
 - △ -6.4*5は両端の基板穴を除く。
-6.2*5は両端の2つの基板穴を除く。
DIM B INDICATES FIRST P.C.HOLE
REQUIRED PER PART NUMBER.
FOR PARTIALLY LOADED ASSEMBLIES
P.C.HOLE PATTERN IS REDUCED FROM EACH END.
 - 推奨基板厚: t=1.6±0.05
RECOMMENDED P.C.B. THICKNESS: 1.6±0.05
△ 金メッキ厚標示
COLOR CODING TO INDICATE GOLD PLATING
黄色: 0.1µmMIN. YELLOW : 0.1µmMIN.
緑色: 0.38µmMIN. GREEN : 0.38µmMIN.
オレンジ色: 0.76µmMIN. ORANGE : 0.76µmMIN.
無色: 1.27µmMIN. UNMARKED: 1.27µmMIN.
 - ハウジングの色は、グレイ。
HOUSING COLOR IS GRAY.



6	6	5.08 (.200)	3.46 (.136)	1.27 / (50)	52018-6645
				0.76 / (30)	↑ -6635
6	4	3.05 (.120)	4.48 (.176)	0.38 / (15)	-6625
				0.1 / (4)	-6615
				1.27 / (50)	-6445
6	2	1.02 (.040)	5.49 (.216)	0.76 / (30)	-6435
				0.38 / (15)	-6425
				0.1 / (4)	-6415
				1.27 / (50)	-6245
				0.76 / (30)	-6235
				0.38 / (15)	-6225
				0.1 / (4)	52018-6215
POSITION	CIRCUITS	A	B	金メッキ厚 µm/(µ in) GOLD PLATING THK(MIN.) µm/(µ in)	製品番号 ENG. No.

材料 MATERIAL	注参照 SEE NOTES	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
仕上げ FINISH	注及び表参照 SEE NOTES AND CHART	EDP. NO. —#—	
適用電線範囲 WIRE RANGE	—#—	ENG. NO.	REV
被覆外径 INS. RANGE	—#—	SD-52018-6**5	B
角 度 ANGLE	+3°	TITLE 名称 MODULAR JACK HOUSING ASS'Y	
30 以上 TOP OVER	10.3 100%	DRAWN BY '00/4/13 K.KOYAMA	
10 以下 30 未満 UNDER	10.25 100%	CHK'D BY '00/4/13 M.FUKUSHIMA	
10 未満 UNDER	10.2 100%	APP'D BY '00/4/13 M.FUKUSHIMA	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		尺 度 SCALE 4-1	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM			

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX(JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス(株)の所有する情報を含むもので 当社の許可なく複製を禁止する。

MXJ-8